

证券代码：688233

证券简称：神工股份

锦州神工半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位及人员	富国基金、长信基金、景顺长城基金、伟星资管、展博投资、长城基金、绿色发展私募股权、宝盈基金、尚诚资产、农银汇理基金、中信建投证券、华安基金、申万菱信基金、博笃投资、光大永明资管、平安证券、厦门财富顾问、东兴基金、信达澳亚基金、中银国际证券、百嘉基金、工银资管全球、中泰证券研究所、鹏华基金、睿远基金、国联基金、国泰海通证券、光大保德信基金、博远基金、富安达基金、中国人寿资管、华泰上海资管、创金合信基金、国泰基金、上银基金、天风证券、马可波罗中国资管、玄元私募、人保健康、东吴基金、山东国托、东北证券、申万宏源证券、永赢基金、中银三星人寿、弘洛私募、中信保诚基金、浙商证券研究所、青骊投资、统一投信、平安基金、渊泓投资、大家资管、益昶资产、华夏东方养老资管、易方达基金、东方证券、诺安基金、度势投资、国信证券、信银理财、杭银理财、众安保险资管、全天候基金、招商基金、睿郡资产、长城证券、嘉实基金、中信证券、中邮证券
时间	2026年4月27日
地点	线上会议
接待人员	董事会秘书兼财务总监常亮先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、关于第一季度业绩的说明</p> <p>2026年第一季度，公司实现营业收入约1.12亿元，较上年同期增长6.22%，主要系公司大直径硅材料业务境外收入增加所致；实现归属于上市公司股东的净利润约2,539万元，较上年同期减少10.96%，主要系公司增加研发投入及期间费用有所增加所致。</p> <p>二、公司主营业务的经营情况</p> <p>存储芯片供不应求，引领全球半导体产业加速成长，公司各项业务迎来发展</p>

机遇：

大直径硅材料业务受到境外市场需求传导带动，开工率持续上升，销售额增长，已进入景气区间；

硅零部件业务已在中国半导体零部件国产供应链中发挥独特作用，公司已经是中国主流等离子刻蚀设备厂商和存储芯片制造厂的供应商，该业务的客户结构持续改善；

半导体大尺寸硅片业务的市场竞争格局发生有利变化，公司市场拓展取得成效，开工率有所提升。

三、中国存储芯片产能增长对公司的影响

管理层认为，纵观过去五十余年的全球半导体产业历史，存储芯片作为大宗品，其产能的重心转移，向来是全球芯片制造产能转移的先声——从美国到日本的转移，以日本东芝公司的崛起为标志；从日本到韩国及中国台湾的转移，以韩国三星公司的崛起为标志。正在发生的第三次转移，很可能以中国存储芯片制造厂商的崛起为标志。

2025年第三季度以来，国际领先的存储厂商相继宣布退出消费级存储芯片业务，让出了广阔的全球消费级存储芯片的市场空间，为中国本土存储芯片制造厂商提供了难得的机遇。后者有望发挥中国在消费电子终端、智能网联汽车、具身智能机器人等领域的庞大潜力，赢得未来全球市场。此外，中国本土人工智能产业对高端存储芯片产能的渴求，也是中国本土存储芯片的长期发展动力。

综上，有志于成为世界级公司的中国厂商，必须抓住这次产业转移所带来的机会。

公司的大直径硅材料产品及其制成品硅零部件，是高端存储芯片制造所需等离子刻蚀环节中的核心耗材，开工率越高、刻蚀强度和次数越多，消耗量越大。根据公司自主调研数据，2026年，中国大陆硅零部件市场规模有望达到约70亿元人民币。公司将稳扎稳打，力争抓住未来几年中国存储芯片产能大规模建设、国产化率提升的机遇。

四、公司对潜在地缘政治事件的影响评估

	<p>公司没有日资背景，乃是一家由中资团队创立的中国本土企业，致力于中国集成电路制造核心工艺材料和零部件的国产化建设。目前公司大部分收入来自中国本土市场，已在供应链国产化方面取得长足进展。</p> <p>当前，中国本土半导体材料和零部件产业仍处于起步阶段，地缘政治事件对供应链的潜在影响既是挑战更是机遇。</p> <p>公司将密切关注事态发展，提前筹划供应链寻源和国产化工作，加强库存管理，争取在未来的国产化浪潮中取得佳绩。</p> <p>五、公司对2026年半导体市场的展望</p> <p>展望后续经营，公司将积极把握半导体市场特别是存储芯片市场境内外“同频共振”的历史机遇，计划实现大直径硅材料业务境外市场的收入突破，保质保量完成硅零部件业务的产能扩充并持续优化客户结构。公司还将密切研判当前地缘政治经济宏观事件频发态势下的国际半导体供应链重组动向，善用公司多年深耕海外市场所积累的经验和资源，为股东创造价值。</p>
附件清单	无
日期	2026年4月27日